

无锡帝科电子材料股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回 报措施和相关主体承诺（修订稿）的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）的相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）就本次向特定对象发行股票相关事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况如下：

（一）本次发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

1、主要假设和前提

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不代表公司对 2026 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担任何赔偿责任。

公司对 2026 年度主要财务指标的测算基于如下假设：

（1）假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

（2）假设本次发行于 2026 年 9 月实施完毕。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以实际发行完成时间为准。

(3) 假设本次发行股份数量按照上限计算，为 43,583,922 股；本次发行募集资金总额亦按照上限计算，为 276,000.00 万元，本次测算不考虑发行费用。本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为测算目的假设，最终以中国证监会予以注册发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

(4) 在预测公司 2026 年末总股本和计算每股收益时，以本次发行前总股本 145,279,743.00 股为基础，仅考虑本次发行股票对总股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化。

(5) 2025 年度归属于母公司股东的净利润为-27,645.20 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 16,344.10 万元。假设 2026 年实现的归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别按照以下三种情况进行测算：①较 2025 年度持平；②较 2025 年度下降 20%；③较 2025 年度上升 20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）。

(6) 未考虑本次发行募集资金到账后，对公司其他经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

(7) 不考虑公司未来现金分红的影响。

(8) 假设在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司未来资本公积金转增股本、送股、分红等其他对股份数有影响的因素。

(9) 基本每股收益与加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》的有关规定进行测算。非经常性损益按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目进行界定。

2、对主要财务指标的影响

基于上述情况及假设，公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目		2025 年度	2026 年度	
			发行前	发行后
总股本（万股）		14,527.97	14,527.97	18,886.37
假设 1：公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润与 2025 年持平				
归属于母公司所有者的净利润（万元）		-27,645.20	-27,645.20	-27,645.20
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）		16,344.10	16,344.10	16,344.10
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益（元/股）	-1.92	-1.90	-1.77
	稀释每股收益（元/股）	-1.92	-1.90	-1.77
	加权平均净资产收益率（%）	-16.93	-19.23	-12.99
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润	基本每股收益（元/股）	1.14	1.13	1.05
	稀释每股收益（元/股）	1.10	1.08	1.01
	加权平均净资产收益率（%）	10.01	11.37	7.68
假设 2：公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2025 年下降 20%				
归属于母公司所有者的净利润（万元）		-27,645.20	-33,174.24	-33,174.24
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）		16,344.10	13,075.28	13,075.28
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益（元/股）	-1.92	-2.28	-2.12
	稀释每股收益（元/股）	-1.92	-2.28	-2.12
	加权平均净资产收益率（%）	-16.93	-23.53	-15.80
归属于母公司所有者扣除非经常性损益后净利润	基本每股收益（元/股）	1.14	0.90	0.84
	稀释每股收益（元/股）	1.10	0.87	0.81
	加权平均净资产收益率（%）	10.01	9.27	6.23
假设 3：公司 2026 年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润较 2025 年上升 20%				
归属于母公司所有者的净利润（万元）		-27,645.20	-22,116.16	-22,116.16
归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润（万元）		16,344.10	19,612.92	19,612.92
归属于母公司所有者的净利润	基本每股收益（元/股）	-1.92	-1.52	-1.42
	稀释每股收益（元/股）	-1.92	-1.52	-1.42
	加权平均净资产收益率（%）	-16.93	-15.09	-10.26
归属于母公司所	基本每股收益（元/股）	1.14	1.35	1.26

有者扣除非经常性损益后净利润	稀释每股收益（元/股）	1.10	1.30	1.21
	加权平均净资产收益率（%）	10.01	13.38	9.10

经测算，本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加，短期内每股收益、加权平均净资产收益率等指标存在一定程度的摊薄，但长期来看，本次募投项目的实施将有利于提升公司的综合实力和市场竞争力，增强公司的盈利能力，为公司和投资者带来更好的投资回报，促进公司持续、稳定发展。

（二）关于本次发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次发行股票募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会有一定幅度的增加。但由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的时间，净利润在短期内无法与股本和净资产保持同步增长，因此公司每股收益和净资产收益率在短期内存在被摊薄的风险。特别提醒投资者理性投资，关注本次发行可能摊薄即期回报的风险。

（三）董事会选择本次融资的必要性和合理性

本次发行的募集资金投资项目均经过公司董事会谨慎论证，项目的实施有利于提升公司的研发实力和生产能力，抓住市场机遇，优化产品结构，满足下游市场技术迭代需求，提升公司的核心竞争力，巩固公司行业地位，增强公司的可持续发展能力。具体分析请参见本预案中“第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”的相关内容。

（四）公司本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司主要从事高性能电子材料的研发、生产和销售，可广泛应用于光伏新能源领域，公司主营产品为用于光伏电池金属化环节的导电浆料。此外，随着公司存储板块业务的不断发展，存储芯片目前成为支撑公司收入和盈利不断增长的第二业务板块。

“年产 2000 吨贱金属少银光伏浆料项目”主要从事 TOPCon 银铜浆料和混合贱金属浆料的研发和生产，属于上市公司现有产品的迭代升级，是上市公司在顺应行业少银/无银金属化趋势的情况下，把握技术变革机遇、构筑未来核心竞争力的关键战略举措；本项目的顺利实施不仅能够降低贵金属银价波动带来的

成本压力，更能抢占下一代光伏金属化技术的制高点，对光伏产业整体生产成本的下降有较大帮助；项目建成后，上市公司将形成覆盖“银浆-银铜浆-贱金属浆”的完整产品矩阵，能够为下游电池客户提供更具成本效益、供应链更安全的金属化解决方案，将进一步巩固并提升公司在全球光伏浆料领域的核心竞争力和市场领先地位。

“下一代高效光伏电池金属化浆料研发项目”将通过引进先进研发设备与高层次技术人才，聚焦钙钛矿超低温浆料、低温导电纯铜浆料和低复合、高效率、细线化 BC 导电浆料、太空光伏浆料等新型光伏浆料的研发，增强公司在前沿材料领域的技术储备与产品转化能力。本项目的实施将进一步提升公司在新兴电子材料领域的综合研发实力，加速相关产品在高端市场的产业化应用，为公司开拓新的产品矩阵与市场增长空间。

“存储芯片封装测试基地项目”项目，主要用于现有封装测试产能的提升，募集资金主要用于厂房建设及设备购置。存储业务板块是上市公司近年来重点布局的战略板块。公司的封装、测试产能已无法满足市场需求。本次募投项目的实施，可以极大补充存储芯片的封装测试产能，夯实公司第二发展曲线，提高公司投资价值及盈利能力。

“半导体封装研发中心项目”项目，主要用于购置研发厂房建设、研发设备的购置等。公司目前已掌握 DRAM 多层堆叠（8~16 层叠 Die）封装、30um 超薄 Die 封装、多芯片集成（SoC+DRAM 合封）、SIP 倒装封装以及 WLCSP、Fan-out 等先进封装技术。随着 AI 算力时代的全面到来，存储芯片对封装技术提出了更高要求，高带宽存储（HBM）、Chiplet 集成等先进封装成为行业发展的核心方向。本项目聚焦混合键合、硅通孔连接等下一代先进封装核心工艺研发，将有助于上市公司在前沿技术领域构建更深厚的知识产权壁垒和技术储备，进一步巩固现有的一体化产业链优势，为存储业务的可持续发展提供核心技术支撑。

（五）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

公司坚持以人才发展为核心，凭借多年的积累，拥有了经验丰富的管理人员、技术团队和生产团队。公司的管理团队对光伏行业的发展以及客户需求有深刻认识，能够很好地把握公司的新兴业务和未来发展方向，深厚的技术积累、经验丰

富的研发和生产管理人才、完善的研发体系，能够有效推进本次募投项目的实施。TOPCon 银铜浆料和混合镍贱金属浆料均具有广阔的市场前景，公司在光伏电池领域常年积累的客户优势、良好的品牌知名度、较强的市场占有率优势均为本次募投项目的顺利实施提供了充分的市场保障。

在存储业务方面，公司已具备扎实的封装技术基础，上市公司子公司因梦控股及江苏晶凯拥有经验丰富的资深技术管理团队，已掌握 DRAM 多层堆叠、超薄 Die 封装、多芯片集成、SIP 倒装封装及 WLCSP、Fan-out 等封装技术，本次研发的混合键合和硅通孔连接属于现有技术的自然延伸与升级；同时，2026 年 3 月国际半导体封装领域权威专家史国钧博士加盟公司出任首席战略科学家，其逾三十年的先进封装与电子材料学术积淀，与本次重点攻关方向高度契合，可为项目实施提供核心技术引领。产业化层面，公司一体化布局为研发成果转化提供高效通道，已形成"芯片应用性开发设计—晶圆测试—封装及测试"的完整产业体系，募投项目可直接在产业链内实现快速验证和产业化应用，缩短技术突破到产品上市的时间周期，提升研发投入产出效率。

(六) 公司对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过坚持发展战略、加强内控制度、完善分红政策、严格执行募集资金管理制度等措施，从而提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展，以填补回报。具体措施如下：

1、加速推进募集资金投资项目投资建设，尽快实现项目预期效果

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务，符合国家产业政策和公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投资项目可有效提高公司主营业务能力、巩固市场地位、提升综合研发能力和创新能力。本次募集资金到位前，为尽快实现募集资金投资项目效益，公司将积极调配资源，力争提前完成募集资金投资项目的前期准备工作；本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目建设，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争早日实现预期效益，降低本次发行导致的即期回报被摊薄的风险。

2、加强募集资金管理，保障募集资金合理规范使用

本次募集资金到位后，将存放于董事会指定的募集资金专项账户。公司将严格按照《募集资金管理办法》及相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，完善并强化投资决策程序，严格管理募集资金的使用，防范募集资金使用风险。同时，在募集资金使用过程中，公司董事会将根据募集资金用途及募集资金投资项目建设进度合理安排使用募集资金，定期对募集资金使用情况进行全面核查，确保募集资金合理规范使用。

3、不断完善公司治理结构，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

4、严格执行公司分红政策，强化投资者回报机制

公司现行《公司章程》中利润分配政策符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求。公司在主营业务实现健康发展和经营业绩持续增长的过程中，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，给予投资者持续稳定的合理回报。此外，公司制定了《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，建立了对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，有利于保证利润分配政策的连续性和稳定性。

（七）公司控股股东、实际控制人关于公司本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

公司控股股东、实际控制人对公司本次发行摊薄即期回报采取填补措施事宜做出以下承诺：

“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本

人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；

3、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补被摊薄即期回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”

(八) 公司董事、高级管理人员关于公司本次发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺接受由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任；

7、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。”

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司董事会

2026年7月8日